



株式会社東京精密(証券コード7729)

Web説明会

2024年3月29日

将来の事象に係わる記述に関する注意：

本資料及び当社代表者が口頭にて提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、今後の当社の実際の業績が、本資料における記述、及び当社代表者が口頭にて提供する情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 事業機会

05 サステナビリティ

06 よく頂く質問

07 株主還元

代表取締役会長CEO 吉田 均

茨城県生まれ、茨城県育ち

1983年 当社入社

2000年 精密計測機器部門 技術部門リーダー

2005年 取締役

2007年 計測社(精密計測機器部門) カンパニー長

2011年 代表取締役

2015年 代表取締役社長CEO

2022年 代表取締役会長CEO (現任)



座右の銘: 虚心坦懐

趣味: ゴルフ

他: 2010年~2016年
2017年~2019年
2020年~

日本精密測定機器工業会
同工業会
同工業会

会長
副会長
会長 (現職)

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 事業機会

05 サステナビリティ

06 よく頂く質問

07 株主還元

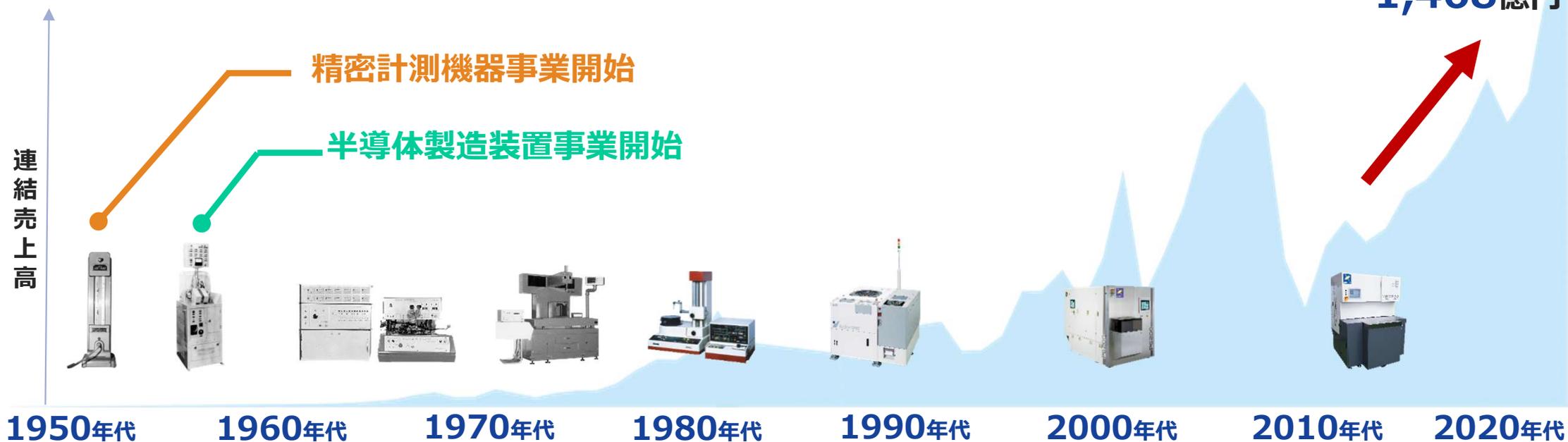


- **会社商号** 株式会社東京精密 (Tokyo Seimitsu Co., Ltd.)
- **事業内容** 半導体製造装置と精密計測機器の製造販売
- **設立** 1949年3月28日
- **本社** 東京都八王子市
- **連結子会社** 国内6社、海外11社 (他 非連結・関係会社13社)、19か国で展開
- **従業員数** 約3,800名 (期末臨時従業員、非連結子会社従業員を含む)
- **資本金** 11,372百万円 2023年12月末時点

成長の軌跡

技術革新へのチャレンジ精神で、世界のモノづくりの進化を支える

2022年度 売上高
過去最高業績達成
1,468億円



半導体業界の動き

トランジスタ誕生

ICチップ誕生

LSI 多機能化

パソコン 普及

スマートフォン普及

IoT、5G
爆発的普及

精密測定機器業界の動き

メートル法
実施

モータリゼーションの波

大気汚染問題

日本車黄金期

自動車業界
再編

ハイブリット車
登場

新エネルギー
自動車登場



ACCRETE + TECHNOLOGY

「共生」

「技術」

世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して
世界No.1の商品を創り出し、
皆様とともに大きく成長していく

東京精密のめざす姿

- 未来を見据え、全てのステークホルダーの皆さまと課題を乗り越え、持続可能な未来を創り上げていきます

パーパス

計測で未来を測り、半導体で未来を創る

ビジョン

- 東京精密は“夢のある未来”を築く一員であり続けます

ミッション

- 世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品を創りだし、皆さまと共に大きく成長していく
- WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう

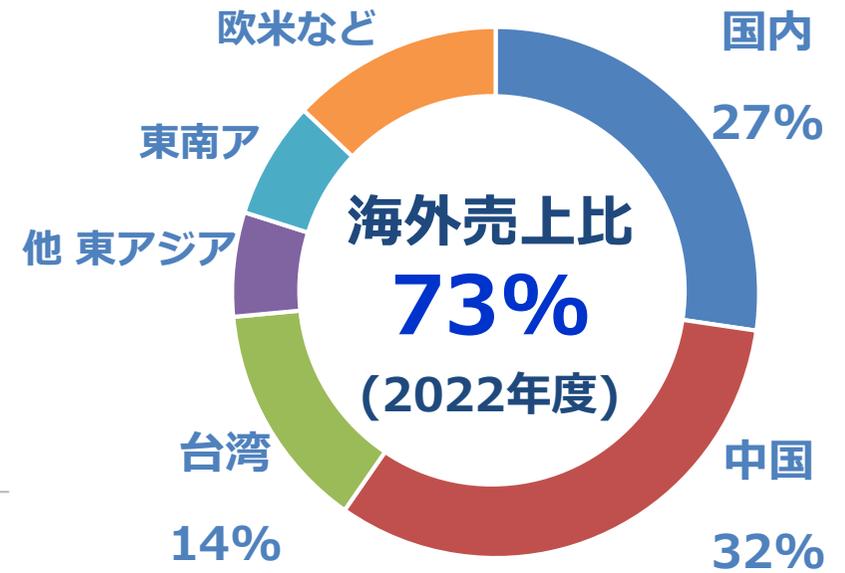
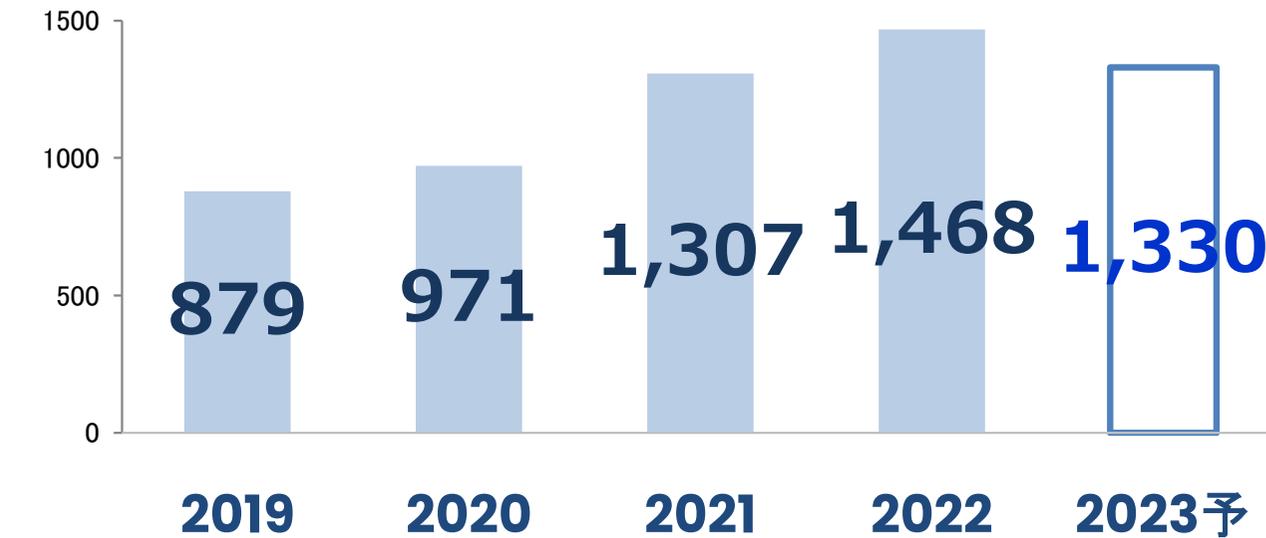
バリュー

- お客さま、株主の皆さま、サプライヤさま、従業員、地域社会、国際社会など全てのステークホルダーとの間でWIN-WINの関係を創りあげ、持続可能な社会の実現に向け積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めます

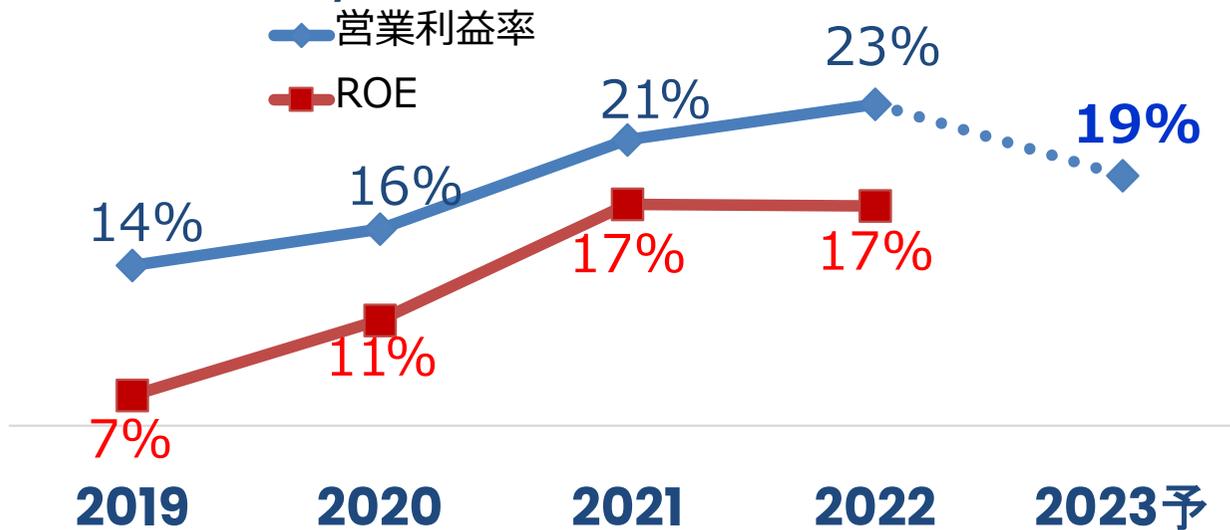
損益・財務ハイライト



売上高



営業利益率, ROE



01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 事業機会

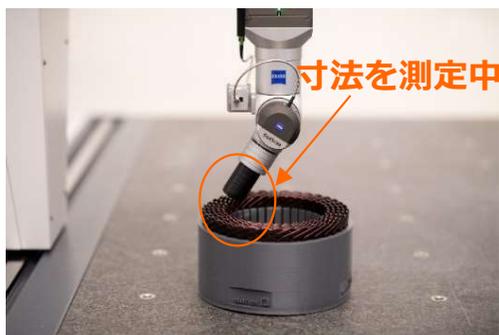
05 サステナビリティ

06 よく頂く質問

07 株主還元

精密計測機器事業

2022年度売上 344億円



精密な機械部品の、
長さ/粗さ/丸さなどを
「精密に測る」機器

モノが設計通りにできて
いるかを確認する



半導体製造装置事業

2022年度売上 1,123億円



ハイテク機器内の
半導体や電子部品を
「造る・検査する」装置

特に検査装置の
「プローバ」に強み



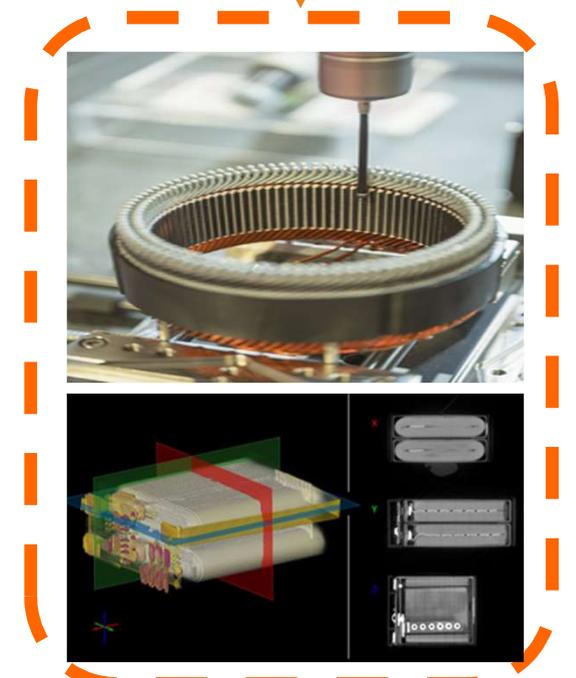
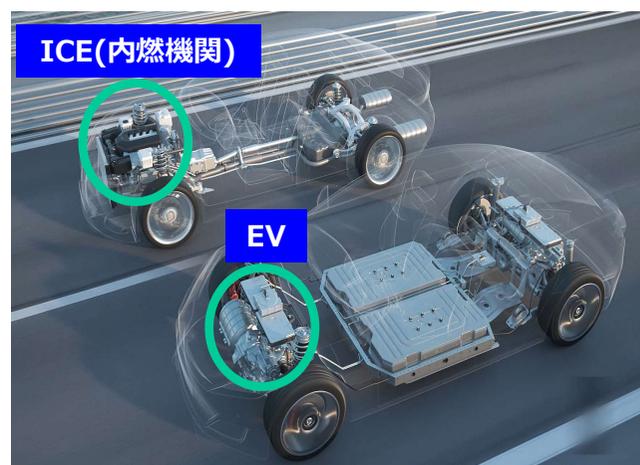
当社は、
2つの事業セグメントで
構成される会社です。

設計

製造

検査

完成



精密計測機器による「確認」



➤ 測れないものは作れない
→ 「長さ・粗さ・丸さ」などを測る機器群の事業

長さを測る



三次元座標測定機

粗さを測る



粗さ・輪郭測定機

丸さを測る



真円度・円筒形状測定機

加工状態を測る



各種センサ

電気の流れを測る



充放電試験システム

自動車・二輪

- モノづくり産業に占める自動車業界の割合自体が多い
- 部品の多くが性能に直結 (=高精度の計測が必要)
- EV用の部品需要も高まっている



他 官公庁・金型など

機械・機械部品

- 工作機械・半導体・ロボット・医療機器・部品(ベアリング)など
- 非自動車分野の拡販を進めている



2022年度
計測事業
分野別販売高
(当社調べ)

航空機部品

- 大型部品の高精度測定





スマートフォン
パソコン



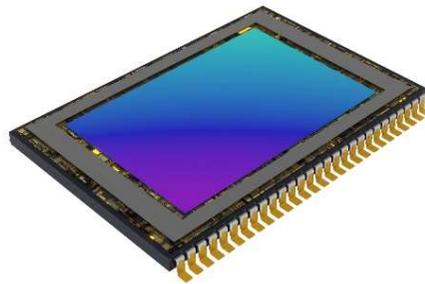
サーバー



AI



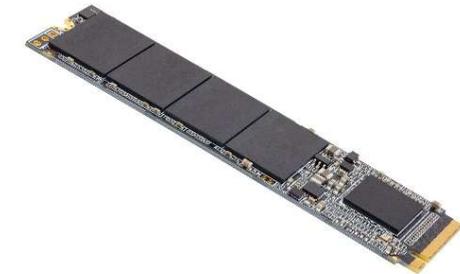
車載デバイス



画像センサー



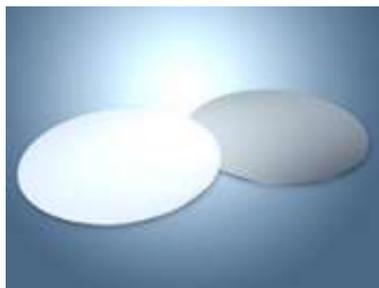
ロジック半導体



メモリ半導体

- 先端技術は、「半導体デバイス」「電子部品」によってできている
 - ・ これらを製造するためには特殊な装置が必要(=半導体製造装置)
 - ・ 当社はこのうち、検査装置および加工装置を提供

ウェーハ製造工程



エッジ グラインダ

ウェーハ壁面の
研削加工

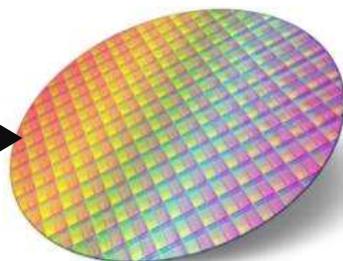


高剛性 研削盤

難削材ウェーハの
研削加工



前工程 (配線形成)



CMP装置

配線表面の研磨加工



検査工程 (電気測定)



プロービングマシン

電気測定



後工程 (封止・組立)



ダイシング マシン

チップの個片化



ポリッシュ グラインダ

チップの薄片化

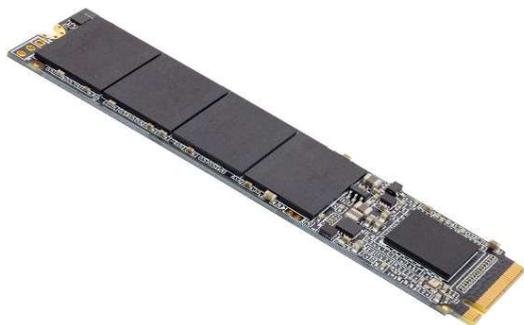


精密切断ブレード



メモリ半導体

- DRAM・フラッシュメモリなど情報を記憶するための半導体



その他

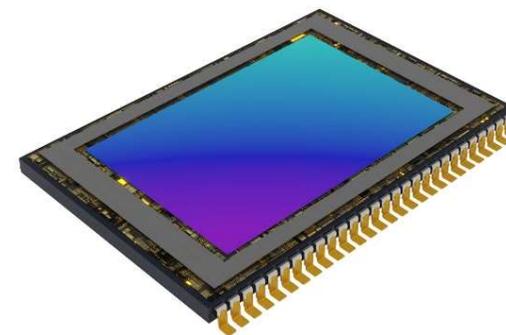
- ウェーハ基盤等の材料加工用途が増加

パワー半導体

- 脱炭素化に向けて需要が増加

電子部品

- 各種フィルタ、画像センサなど



ロジック半導体

- AI、スマートフォンのCPU、通信チップ、ディスプレイICなど様々な制御を行う半導体

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 事業機会

05 サステナビリティ

06 よく頂く質問

07 株主還元

メガトレンド

Society 5.0

(サイバーとフィジカルの融合)

半導体デバイスの
高機能・複雑化・三次元化

半導体・電子部品の桁違いの
大量生産・大量消費の時代

半導体、航空機、医療など
非自動車分野の測定ニーズ拡大

気候変動

超高効率の次世代パワー半導体
(SiC/GaNなど)の実用化

カーボンニュートラルに向けた
NEV・再生可能エネルギー市場拡大

人口動態の変化

労働人口減少に対応したDX化・
AI普及による半導体ニーズの増加

労働人口減少による
モノづくり自動化の流れ

世の中が大きな変化を迎えている

事業機会

検査、計測の高度化・重要性の高まり

高精度の半導体加工装置の需要増加

非接触・高精度計測の需要増加

SiCなど、革新素材に対応した加工装置の需要拡大

NEV拡大に伴う高精度測定需要の増加やバッテリー測定などの新たなニーズ

ロボットと測定機を組み合わせた高精度部品の全数測定のニーズ

事業戦略

2022-2024年度 中期経営計画

半導体製造装置

- 検査装置(プロービングマシン)のデパート化
- 加工装置の業容拡大・強化
- お客さまのニーズにマッチした商品の開発・販売
- 計測技術と半導体製造装置の融合による高付加価値製品の開発・販売

精密測定機器

- 既存分野の需要獲得継続
- NEV向けのバッテリー測定、受託ビジネスの獲得
- 非自動車部門(半導体、医療など)やファクトリーオートメーションの開拓

サステナビリティ重要課題



中期経営計画(2022年5月開示)



➤ 2024年度 定量目標を設定

ROE	15%以上
売上高	1,700億円 (半導体1,320億円/計測380億円)
営業利益	375億円 (営業利益率：22%)

➤ 全社取り組み

研究開発投資

先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化

生産キャパシティ拡充

飯能工場稼働(2023年度)
SPEキャパシティ 1,400億+α
その次の名古屋工場投資も実施

環境投資

2030年CO2排出量 50%削減
(2018年度比)に向け
必要な投資を検討

投資評価指標

社内評価基準にROICを検討

アプリケーション強化

各国拠点におけるデモ設備強化

サステナビリティ

ESG各取り組み強化

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 事業機会

05 サステナビリティ

06 よく頂く質問

07 株主還元

➤ マテリアリティ(重要課題)

E 環境	環境問題を解決する製品・事業活動
	提供した製品・サービスによる環境貢献
S 社会	社会課題を解決する高付加価値製品
	サプライチェーンの構築
	多様な人々が活躍でき、心身ともに健康で働きがいのある職場づくり
G ガバナンス	人権の尊重
	企業活動を支える経営基盤
	コンプライアンス
	リスクマネジメントの強化

① 多様な人々が活躍でき、 心身ともに健康で働きがいのある職場づくり

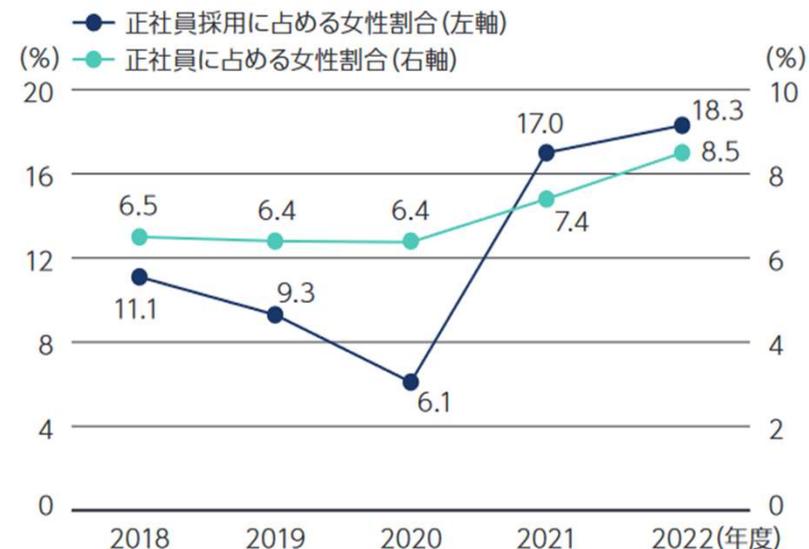


➤ 女性活躍推進

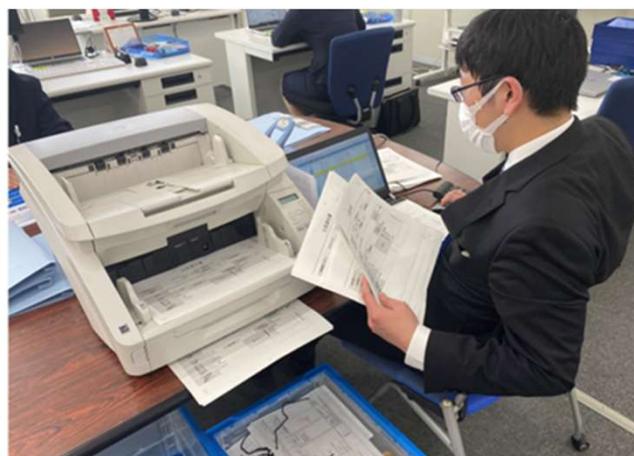


2025年度の目標

採用者に占める女性割合（正社員） **20%**
従業員に占める女性割合（正社員） **10%**



➤ 障がい者雇用促進



- ◆ 支援部署を設置、専任指導員が常駐
- ◆ 業務への取り組み状況や、今後のなりたい目標を関係者と共有して成長をサポートしていく

② 企業活動を支える経営基盤



取締役会の独立性、客観性、多様性



吉田 均
代表取締役 会長CEO



木村 龍一
代表取締役 社長COO
半導体社 カンパニー長



川村 浩一
代表取締役 副社長CFO
業務会社 カンパニー長

外国人



伯耆田 貴浩
取締役
半導体社 執行役員常務



塚田 修一
取締役
計測社 カンパニー長



ロミ・プラダン
取締役



秋本 伸治
取締役 監査等委員

独立社外取締役



高増 潔
社外取締役



森 重哉
社外取締役



須永 真樹
社外取締役 監査等委員

女性



相良 由里子
社外取締役 監査等委員



村田 恒子
社外取締役 監査等委員

01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

04 事業機会

05 サステナビリティ

06 よく頂く質問

07 株主還元

1. 当社の生成AIに関する事業機会は何か？

2. 異なる2つの事業を持つ強みは何か？

➤ 生成AIは 高性能の半導体が必要になる

半導体が複雑化



テスト難度上昇、テスト需要増加



プローバの需要拡大



複数のチップを1つに纏めて性能を向上



貼り合わせる技術が必要となり
面を研削して平坦にすることが重要



グライндаの需要が拡大



当社は“計測技術”を持つ唯一の半導体製造装置メーカー

- 異なる需要の波を持つ事業を有することによる収益の安定化
- 当社だけが提案できる付加価値を提供できる
例えば、半導体製造装置“計測機器ビルトインモデル”



半導体製造装置

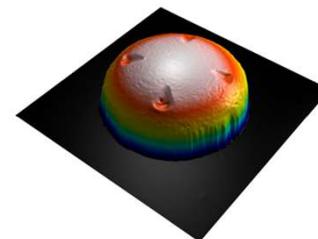


精密計測機器

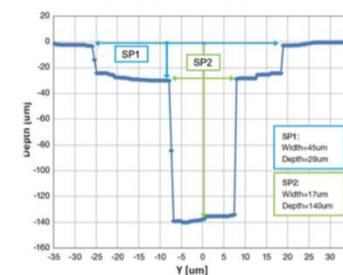


高精度な加工と リアルタイム測定の 両立が可能

テスト後の針跡による
不良検知・判定



ハーフカット後の
断面形状評価



01 自己紹介

02 会社概要

03 各事業の詳細

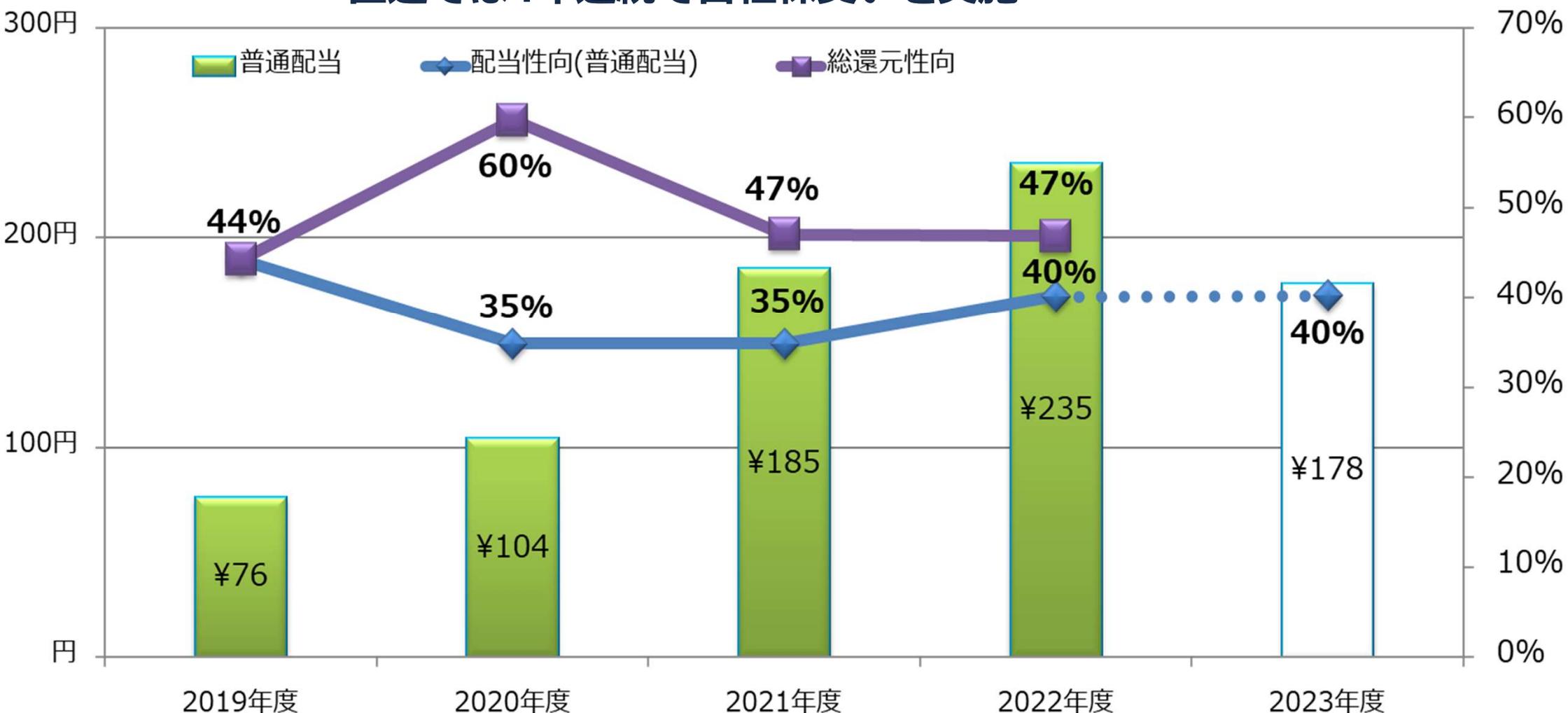
04 事業機会

05 サステナビリティ

06 よく頂く質問

07 株主還元

- 配当：業績連動の利益配分を基本に、連結配当性向40%程度を目安に実施
安定・継続的な配当観点から、利益水準に依らず、年20円配当は維持
- 自己株式取得：剰余金の配当を補完する機動的な利益還元策と位置づけ
直近では4年連続で自社株買いを実施

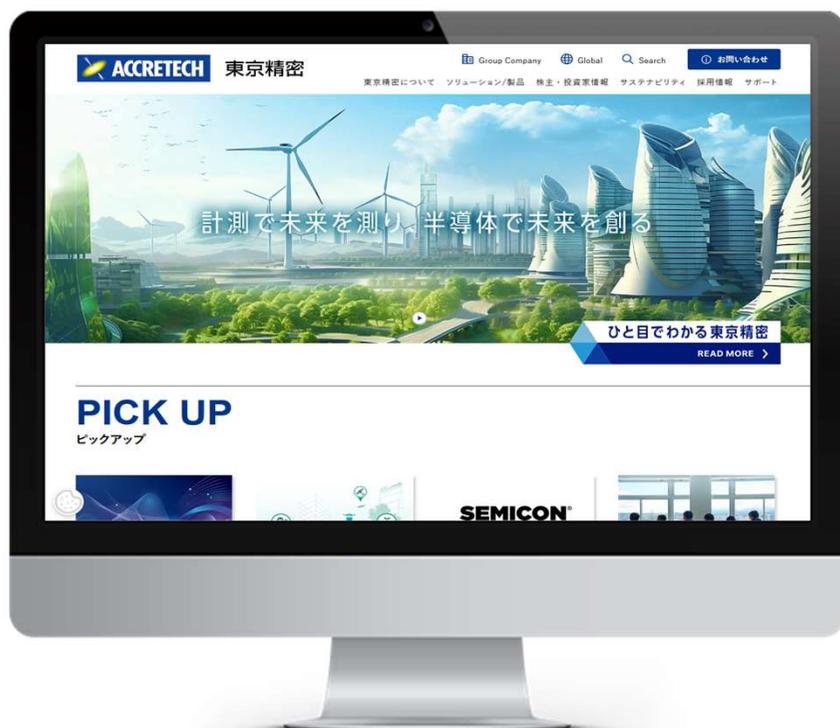




IRサイト



<https://www.accretech.com/jp/ir/index.html>



統合報告書サイト



https://www.accretech.com/jp/ir/integrated_report.html

メール配信サービス



<https://www.accretech.com/jp/ir/mail.html>

ご清聴ありがとうございました



<https://www.accretech.com/jp/>